

Parámetros

Especificaciones	P1,25	P1,56	P1,95
Distancia entre píxeles (mm)	1,25	1,56	1,95
Estructura de píxeles	COB 1R1G1B Virtual	COB 1R1G1B Proceso Flip Chip	
Densidad de píxeles (puntos/m²)	640 000	409 600	262 144
Tamaño del módulo (ancho x alto) (mm)	250*250	250*250	250*250
Material de la carcasa trasera	Sin carcasa trasera		
Resolución del módulo (ancho x alto) (puntos)	128*128	160*160	128*128
Método de escaneo	1/50	1/40	1/64
Frecuencia de actualización (Hz)	◆3840	◆3840	◆3840
Iluminación (cd//m2)	600~700	600~700	600~700
Circuito integrado del controlador	Controlador de corriente constante		
Relación de contraste	◆8000:1	◆8000:1	◆8000:1
Tamaño del gabinete (Ancho x Alto x Profundidad)	500*250*50 / 500*500*50 / 1000*250*50 / 1000*500*50		500*250*50 / 500*500*50
Material del armario	Aluminio fundido a presión		
Peso del armario (kg)	4,3/6,4/8,9/11,5		4,3/6,4
Métodos de instalación/mantenimiento	Instalación delantera y trasera / Mantenimiento delantero		
Temperatura de color/uniformidad de luminancia	3200-9300 K; ◆98 %		
Uniformidad cromática	±0,003Cx, Cy		
Vista horizontal/vertical	◆170°		
Tarjeta receptora estándar	A8S-Pro	A8S-N	
Frecuencia de imagen (Hz)	50/60		
Nivel de protección	IP30		
Método de interfaz de alimentación	Conector plano de tres polos		
Rango de tensión de entrada CA (V)	100-240		
Consumo máximo de energía (W/m2)	5350		
Consumo medio de energía (W/m²)	5170		
Rango de temperatura y humedad de funcionamiento	-20 ° C, _+50 ° C, 10 %, __95 % HR		
Rango de temperatura y humedad de almacenamiento	-40 ° C, _+70 ° C, 10 %, __95 % HR		
Vida útil (H)	100 000		
Tiempo medio entre fallos (H)	◆10000		



HIGHLED PRO SOLUTIONS SL
Parque Comercial Meixoeiro-Espaciogeo
Ctra. De Madrid, 152 – BOX D-103
36318 VIGO (Pontevedra)
España
Tel.: +34 663 110 681
Correo electrónico: sales@highledpro.com
www.highledpro.com



Pantalla LED Indoor COB con chip completo

Armario de aluminio fundido a presión (500 x 500 mm)

Serie HLP-X-COB
(P1.25, P1.56, P1.95, P2.6, P2.9, P3.9)

Indoor



Pantalla LED Indoor COB HIGHLED PRO

Tecnología Full Chip de Última Generación
Tecnología COB de encapsulado completo para mayor resistencia, mejor disipación térmica y calidad de imagen superior.

Pantalla LED Outdoor COB con chip completo

Armario de aluminio fundido a presión

Serie HLP-X-COB
(500 x 500 mm)



Compatible con P1,25, P1,56 y P1,95

Adopta la tecnología Flip chip COB, de bajo consumo y más estable

Caja de alimentación cableada, sin cableado, más estética

Technical Specifications

•**Module size:** 250mm × 250mm

Compatible pixel pitch: 1.25mm / 1.56mm / 1.95mm

Matching COB technology improves small-pitch display performance with waterproof, dustproof, anti-touch, and anti-bump protection, meeting the requirements of various fixed installation projects.

•**Cabinet sizes:**

1000mm × 500mm; 1000mm × 250mm; 500mm × 500mm; 500mm × 250mm

Supports 90° LED screen configurations and cube LED screen designs.

•**Module design:**

No plastic housing, wired structural design, high precision and high stability.

Elegant internal structure, convenient module assembly, high screen surface flatness, quick installation, and easy maintenance.

•**Redundancy:**

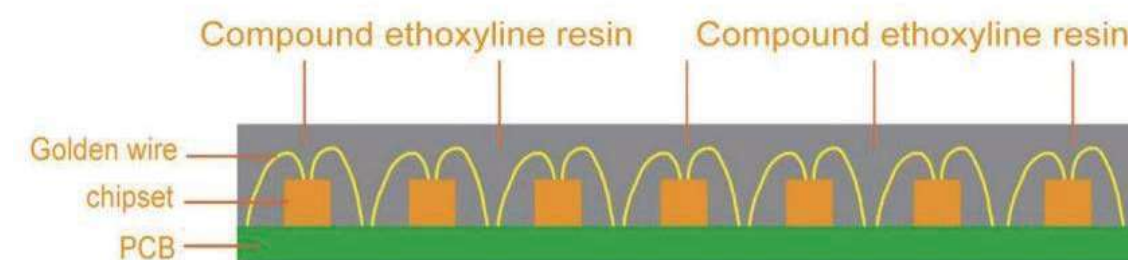
Supports dual backup for power supply and control system.

•**Installation options:**

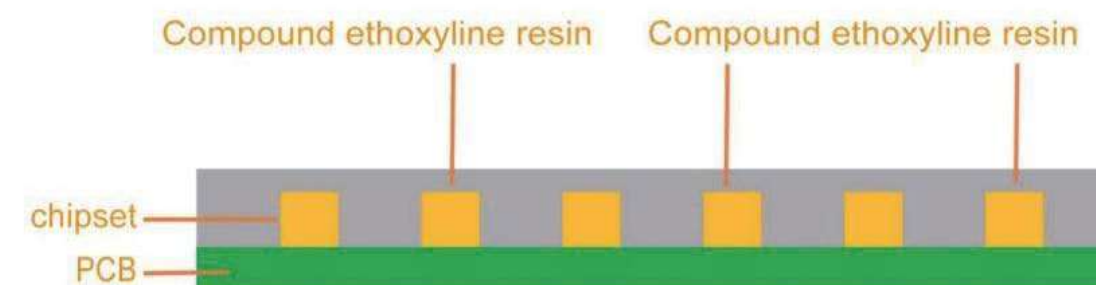
Front and rear installation supported.

Front service design saves space and reduces costs.

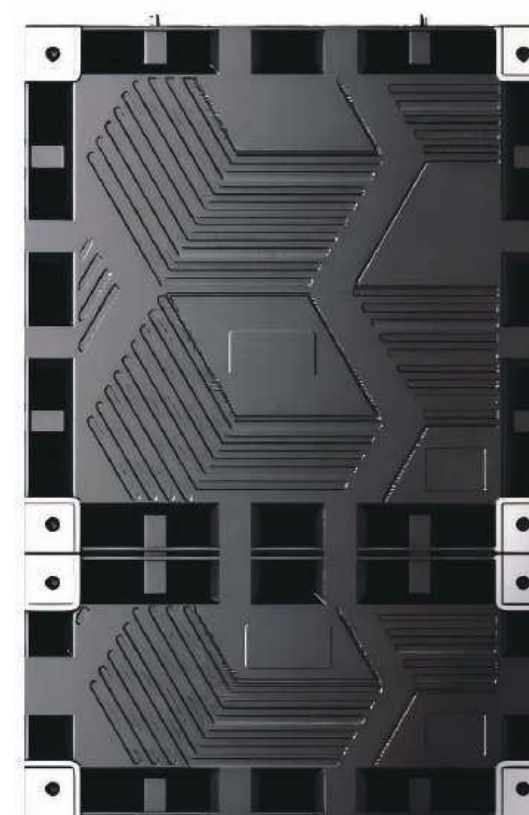
Supports mixed cabinet sizes.



COB (regular technology)



Flip Chip COB



Multi sizes mixed



90° led screen